



化 基 功 二

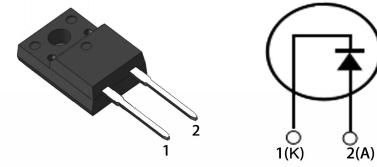
产品

， 于 使
不受 响 关
作 175℃
反向 复
向 复 压

产品		
≤	℃	

产品优

单 器件
大 低 关
器件中
低 对 依



域

关 M ， 功 因 FC
动， 光 伏 变 器， 不 ，
力 发 动 ， 列 ， 动 。



产品型号		封		
G	H	F	G	H

定值

参		件	值	单位
反向 复 值 压	M			
反向 值 压	M			
反向 压	DC			
向 均	I _F	c °C c °C c °C		A
向 复 值	I _{F M}	c °C , H , D		A
向不 复 值	I _{F M}	c °C , H		A
功		c °C c °C		
作			°C °C	°C
			°C °C	°C
安		M		N

参		件	值	单位
			典型值	
到 壳	JC			°C

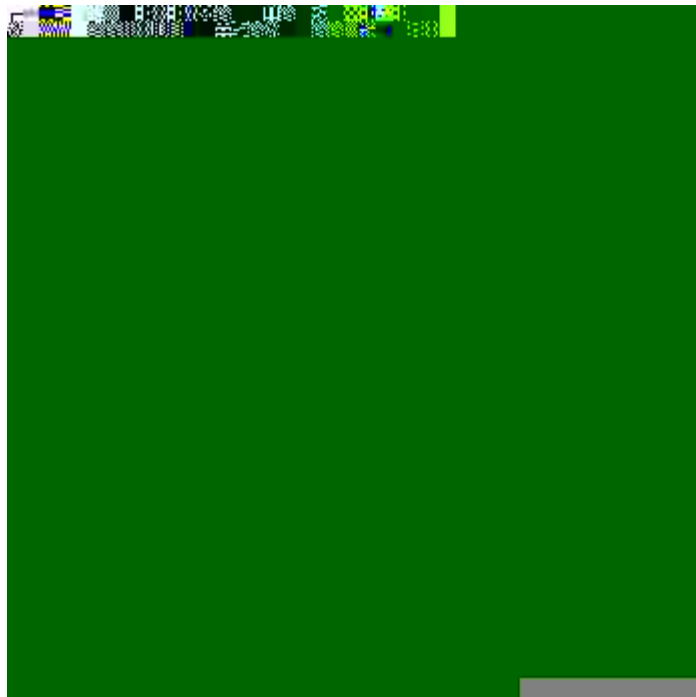
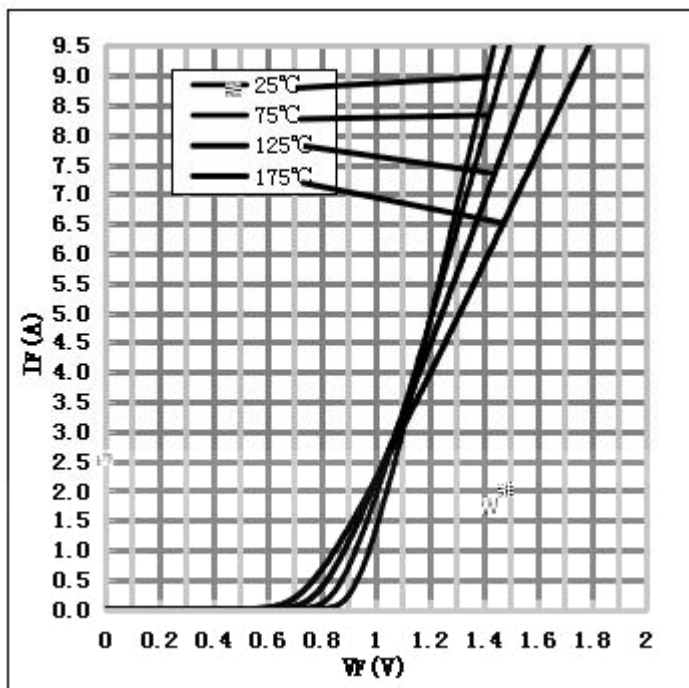
学 ， °C

参	件	值		单位
		典型值	大值	
向压	F	I_F A °C		
		I_F A °C		
反向	I	°C		A
		°C		
存储	c	$= \int$ °C		C
容	C	°C MH		F
		°C MH		
		°C MH		

图

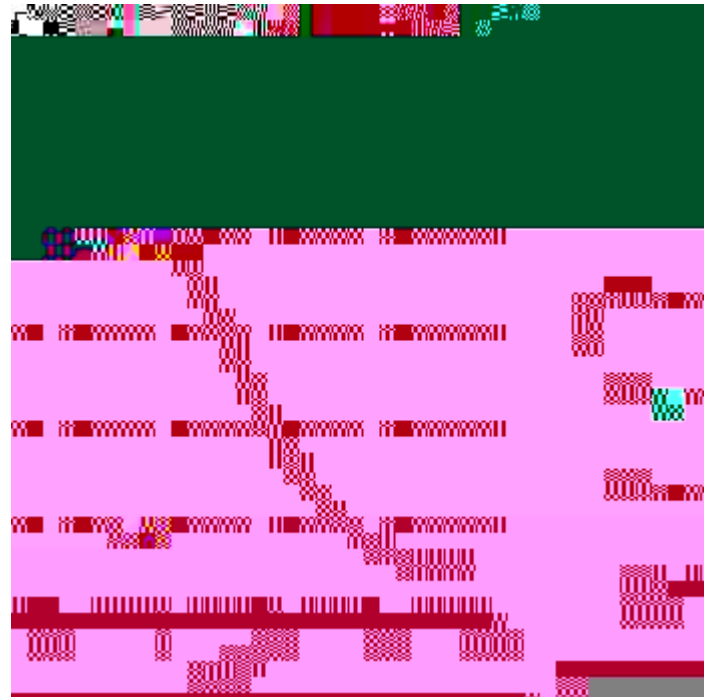
典型 向
IF F, 为参

典型反向
, 为参



不同 下 ()
(, , , ,)

典型 容 反 向 压



封 : _____

单位 : mm

SYMBOL	DIMENSIONS		
	Min	Nom.	Max.
E	0.76	0.80	0.81
F1	1.20	1.30	1.47
F2	1.10	1.20	1.30
G	0.45	0.50	0.53
D	15.80	15.87	15.97

Symbol	Value
Q	2.65, 2.75, 2.85

Notes:
 1. All Dimension Are
 2. Package Body St

1 : 体 于 实 。1 准 国 准化 (1) 于 在全世
围内 关于 和 保 列 准。1 体 三 () 对企业 体
审 、 定和 册 动, 其 在于 审 、 定和事后 企业 体 合1 准, 对 合 准
予合 书 予以 册 全 动。 天 半导体 (北京) 公司 1 : 以及其他 书信 可以
公司官 : _____ C

多 产品信 和公司信 官 :

